**《電路板產業實習媒合平台》**

**企業申請表**

1. **公司基本資料：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司** | 金像電子股份有限公司 | **電話** | 03-4612541 | **類型** | ■電路板□化學□材料□設備□其他 |
| **地址** | 桃園市中壢區西園路113號 | **網址** | <https://www.gce.com.tw/index.html> |
| **聯絡人** | 邱寶萱 | **職稱** | 高級管理師 | **分機** | 21217 | **Email** | sharon\_chiu@gce.com.tw |

1. **公司招募訊息：**

|  |  |
| --- | --- |
| ★**公司介紹** | 金像電子股份有限公司 (GCE) 於1981年創立，在這數十年的經營歷程中一直秉持「品質至上，客戶第一」的原則來服務客戶，隨著全球國際化的趨勢及因應市場需求環境的變遷，除中壢廠外，更斥資設立大陸蘇州廠、常熟廠，將每月生產規模一舉突破百萬平方英尺，並視未來發展計劃，持續擴充產能，以因應客戶之需。本公司產品主要集中於電腦相關應用(如:伺服器、工作站、筆記型電腦、桌上型電腦等)，近年來年更跨足通訊/網路設備、手機及高電流供應器等其他方面發展，鑑於電子產品變化快速和擁有研發技術即擁有市場的觀念，我們將持續不斷的發展新產品及掌握電子產品流行趨勢，期許在激烈的市場競爭中脫穎而出，成為業界的翹楚。基於客戶對品質要求及環保意識的抬頭，公司全心投入製程的改善，先後取得ISO-9001，ISO-14001及ISO-45001等國際品質認證，並建立完善的品質系統，確保產品品質符合客戶需求；另一方面也持續提昇客戶服務水平，分別在美國、歐洲、日本、韓國與新加坡等世界各地設立服務據點，就近提供最快速及最好的服務，並蒐集產品未來發展方向，期許能與客戶成為事業發展的夥伴。綜觀而言，本公司一本「品質至上，客戶第一」的行事原則，不論在產品研發，品質改善，客戶滿意等項目不斷投入心血，確保滿足客戶的需求外，進而強化公司體質，更希望在面對激烈的市場競爭中能夠與客戶攜手合作，實現共同的願景。企業文化 : 誠信、負責、專業、創新【金像榮耀，與您共享】★數位時代 2021年度高價值企業評選第59名★★天下雜誌 2000大製造業排名146名★★天下雜誌 韌性企業200強中成長TOP100排名第80名★ |
| **實習階段** | ★薪資 | □時薪：\_\_\_\_\_\_\_ ■月薪： 29,000元起 □其他： |
| ★保險 | ■勞保■健保 □其他保險： |
| ★膳宿 | ■膳食補助：員工餐廳 □住宿補助：\_\_\_\_\_\_ □交通補助：\_\_\_\_\_\_ |
| 其他福利 | 實習後留任享以下福利:1. 追認實習年資(如實習期滿3個月，自留任後以適用期滿核薪)
2. 留任期滿獎金最高累計10,000元
 |
| 其他福利 | 為培育PCB產業新生代人才，金像電子提供優渥『獎助學金』，歡迎在學表現優異同學申請！意者請洽 人力資源部 03-4612541 分機21215、21217 |
| ★給實習生的招募說明 | 對畢業後的人生感到迷惘嗎在學校學了很多卻不知能用在哪誰說實習只能做雜事金像電子，與你/妳一同成長!【這份實習經驗可以帶給你/妳什麼】對於進入金像電子的實習生，我們提供正職水準的薪資待遇，用心的導師制和完善的學習計劃，充實你的實習生活!我們期待你/妳：★活潑熱情有想法★★有良好應變能力★★願意接受挑戰★看完以上的介紹，快給自己一個加入金像的機會，讓金像寫下你/妳學生生涯最豐富的一頁! |
| 未來若成為正職員工之其他福利 | 留任年資累計，視實習表現給予調薪機會，福利比照正職，如下：※保險類：勞保、健保、出差平安險、提撥勞退金※制度類：夏/冬季制服、緊急協助方案、優秀員工獎勵、資深員工獎勵※設備類：福利社、中央空調宿舍、員工餐廳、汽機車停車場※休假類：特休/年假、陪產假/產檢假、家庭照顧假、女同仁生理假、育嬰假、主管有薪事假、派外訓練假※補助類：員工婚喪喜慶補助、住院慰問、員工急難救助金、生育補助、員工(子女)獎助學金、社團活動補助、研究所在職進修補助※獎金/禮品：年終獎金、績效獎金、生產獎金、提案改善獎金、生日禮金(品)※訓練類：新人訓、各項職能完整教育訓練(管理領導/專業技術/通識教育/共通職能)、特殊證照課程、派外訓練、數位學習平台※員工活動與特惠：新進人員特約醫院免費體檢、在職員工年度健康檢查、福委會優惠團購及特約商店、每月福利社特惠商品、指定店家特惠方案 |

**《電路板產業實習媒合平台》**

**企業申請表**

1. **實習條件申請表：**(1)★為必填(2)本表格若有不足歡迎自行延伸使用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **【項目】** | **實習職務1** | **實習職務2** | **實習職務3** |
| ★職務名稱 | 製程工程實習生 | 材料工程/技術開發實習生 | 新產品工程實習生 |
| ★職務類型 | □OP □RD ■PE | □OP ■RD □  | □OP □RD ■NPE |
| ★部門(或產線) | 製程工程部 | 材料工程部/技術開發部 | 產品開發部 |
| ★地點(或廠區) | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 |
| ★主要工作內容描述 | 1.巡視製程作業程序和品質2.協助品質缺點分析和彙整資料3.追蹤實驗板進度、品質和彙整資料 | 1.製程專案改善2.製程異常處理3.協助新產品開發4.新產品生產流程設計5.主管交辦事項 | 1.樣品製作/製程異常排除與製作進度掌控2.樣品異常改善修正及設計優化調整3.樣品良率彙整與對策提出4.作業途程與作業參數測試及驗證 |
| ★實習期間(可複選) | ■暑期(2022.7~8月)■學期(2022.9~2023.1)■學期(2023.2~2023.6) | ■暑期(2022.7~8月)■學期(2022.9~2023.1)□學期(2023.2~2023.6) | ■暑期(2022.7~8月)■學期(2022.9~2023.1)■學期(2023.2~2023.6) |
| ★所需人數 | 6人 | 2人 |  1人 |
| ★時數/天數(最低需求) | 每周至少： 40時(或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時(或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時(或)每周至少： 5 天 |
| ★加班需求 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 |
| 希望校/系 | 工程/數理化學群(理工科系) | 工程/數理化學群(理工科系) | 工程/數理化學群(理工科系) |
| 英文能力 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 ■中等 □精通 |
| 其他條件要求(技能/語言/軟體/證照等) | □修過電路板學分班□通過電路板工程師初級□其他 | □修過電路板學分班□通過電路板工程師初級□其他 | □修過電路板學分班□通過電路板工程師初級□其他 |
| 其他需要檢附之資料 | ■履歷 ■成績證明□其他： | ■履歷 ■成績證明□其他： | ■履歷 ■成績證明□其他： |
| ★實習職缺屬性 | □僅為階段支援 ■期待後續留任□待評估 | ■僅為階段支援 ■期待後續留任□待評估 | □僅為階段支援 ■期待後續留任□待評估 |
| ★職缺有效期限 | □提出申請後3個月內■提出申請後3-6個月□長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內■提出申請後3-6個月□長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內■提出申請後3-6個月□長期性職缺(不限時) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **【項目】** | **實習職務4** | **實習職務5** | **實習職務6** |
| ★職務名稱 | DRC分析實習生 | CAM實習生 | 客服實習生 |
| ★職務類型 | □OP □RD ■設計工程 | □OP □RD ■設計工程 | □OP □RD ■CS |
| ★部門(或產線) | 工程資料設計 | 電腦輔助製造 | 客服部 |
| ★地點(或廠區) | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 |
| ★主要工作內容描述 | 1.軟體操作 Genesis 與 InCAM Pro2.Gerber Input3.執行DRC分析4.撰寫DRC分析報告5.預排版設計6.他廠DRC分析 | 1.電路板線路影像編輯2.補償及排版3.製程能力分析及Netlist比對4.治工具輸出5.製程改善 | 1.客訴處理2.廠內外溝通協調能力培養3.RMA 判定與開立4.週、月報處理(廠內、客戶端)5.參與客戶端會議 |
| ★實習期間(可複選) | □暑期(2022.7~8月)■學期(2022.9~2023.1)■學期(2023.2~2023.6) | ■暑期(2022.7~8月)■學期(2022.9~2023.1)■學期(2023.2~2023.6) | ■暑期(2022.7~8月)■學期(2022.9~2023.1)■學期(2023.2~2023.6) |
| ★所需人數 | 2人 | 1人 | 2人 |
| ★時數/天數(最低需求) | 每周至少： 40時(或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時(或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時(或)每周至少： 5 天 |
| ★加班需求 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 |
| 希望校/系 | 工程/數理化學群(理工科系) | 工程/數理化學群(理工科系) | 商管/工程/數理化學群(理工科系尤佳) |
| 英文能力 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 □中等 ■精通 |
| 其他條件要求(技能/語言/軟體/證照等) | □修過電路板學分班□通過電路板工程師初級□其他 | □修過電路板學分班□通過電路板工程師初級□其他 | □修過電路板學分班□通過電路板工程師初級□其他 |
| 其他需要檢附之資料 | ■履歷 ■成績證明□其他： | ■履歷 ■成績證明□其他： | ■履歷 ■成績證明□其他： |
| ★實習職缺屬性 | □僅為階段支援 ■期待後續留任□待評估 | ■僅為階段支援 ■期待後續留任□待評估 | □僅為階段支援 ■期待後續留任□待評估 |
| ★職缺有效期限 | □提出申請後3個月內■提出申請後3-6個月□長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內■提出申請後3-6個月□長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內■提出申請後3-6個月□長期性職缺(不限時) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **【項目】** | **實習職務7** | **實習職務8** | **實習職務9** |
| ★職務名稱 | 可靠度實習生 | PQE實習生 | 大數據分析實習生 |
| ★職務類型 | □OP □RD ■QA | □OP □RD ■PQE | □OP □RD ■智慧製造 |
| ★部門(或產線) | 可靠度儀校 | 品質管制部 | 智慧製造整合處 |
| ★地點(或廠區) | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 |
| ★主要工作內容描述 | 1.執行產品可靠度測試及問題分析2.可靠度分析報告撰寫與彙整3.實驗設備操作與維護4.可靠度分析報告撰寫與彙整 | 1.異常處理2.統計分析3.專案進行 | 1.資料收集2.資料整理3.資料分析與建模4.協助模型上線 |
| ★實習期間(可複選) | □暑期(2022.7~8月)■學期(2022.9~2023.1)■學期(2023.2~2023.6) | □暑期(2022.7~8月)■學期(2022.9~2023.1)■學期(2023.2~2023.6) | ■暑期(2022.7~8月)■學期(2022.9~2023.1)■學期(2023.2~2023.6) |
| ★所需人數 | 2人 | 2人 | 1人 |
| ★時數/天數(最低需求) | 每周至少： 40時(或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時(或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時(或)每周至少： 5 天 |
| ★加班需求 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 |
| 希望校/系 | 工程/數理化學群(理工科系) | 工程/數理化學群(理工科系) | 工程/數理化學群(統計系/數學系尤佳) |
| 英文能力 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 ■中等 □精通 |
| 其他條件要求(技能/語言/軟體/證照等) | □修過電路板學分班□通過電路板工程師初級□其他 | □修過電路板學分班□通過電路板工程師初級□其他 | □修過電路板學分班□通過電路板工程師初級□其他 |
| 其他需要檢附之資料 | ■履歷 ■成績證明□其他： | ■履歷 ■成績證明□其他： | ■履歷 ■成績證明□其他： |
| ★實習職缺屬性 | □僅為階段支援 ■期待後續留任□待評估 | □僅為階段支援 ■期待後續留任□待評估 | □僅為階段支援 ■期待後續留任□待評估 |
| ★職缺有效期限 | □提出申請後3個月內■提出申請後3-6個月□長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內■提出申請後3-6個月□長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內■提出申請後3-6個月□長期性職缺(不限時) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **【項目】** | **實習職務10** | **實習職務11** | **實習職務12** |
| ★職務名稱 | 程式開發實習生 | 生產管理實習生 | 測試工程/維修實習生 |
| ★職務類型 | □OP □RD ■IT | □OP □RD ■生管 | □OP □RD ■精修 |
| ★部門(或產線) | 資訊處 | 生產管理部 | 測試工程部 |
| ★地點(或廠區) | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 | 金像電子中壢廠 |
| ★主要工作內容描述 | 1.使用Fine Report報表工具參與資訊處專案的報表開發。 | 1.生產進度安排2.QTA 料號之啟動及追蹤3.客戶訂單OTD管控4.半成品WIP及成品庫存量管控5.Surplus 管控 | 1.機台保養/維修(保持穩定稼動)2.量產TROUBLE SHOOTING3.重要料號跟催4.AOI DRT改善5.SOP/PMP/CHECKLIST制訂6.設備評估(架線)7.現場人員教育訓練8.開發導入新設備 |
| ★實習期間(可複選) | ■暑期(2022.7~8月)□學期(2022.9~2023.1)□學期(2023.2~2023.6) | □暑期(2022.7~8月)■學期(2022.9~2023.1)■學期(2023.2~2023.6) | □暑期(2022.7~8月)□學期(2022.9~2023.1)■學期(2023.2~2023.6) |
| ★所需人數 | 2人 | 2人 | 2人 |
| ★時數/天數(最低需求) | 每周至少： 40時(或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時(或)每周至少： 5 天 | 每周至少： 40時(或)每周至少： 5 天 |
| ★加班需求 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 | □需要□不需要■未定 |
| 希望校/系 | 資訊學群 | 商管/工程/數理化學群(理工科系尤佳) | 工程/數理化學群(理工科系) |
| 英文能力 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 ■中等 □精通 | □略懂 ■中等 □精通 |
| 其他條件要求(技能/語言/軟體/證照等) | □修過電路板學分班□通過電路板工程師初級□其他 | □修過電路板學分班□通過電路板工程師初級□其他 | □修過電路板學分班□通過電路板工程師初級□其他 |
| 其他需要檢附之資料 | ■履歷 ■成績證明□其他： | ■履歷 ■成績證明□其他： | ■履歷 ■成績證明□其他： |
| ★實習職缺屬性 | ■僅為階段支援 ■期待後續留任□待評估 | □僅為階段支援 ■期待後續留任□待評估 | □僅為階段支援 ■期待後續留任□待評估 |
| ★職缺有效期限 | □提出申請後3個月內■提出申請後3-6個月□長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內■提出申請後3-6個月□長期性職缺(不限時) | □提出申請後3個月內■提出申請後3-6個月□長期性職缺(不限時) |

|  |  |
| --- | --- |
| **【項目】** | **實習職務13** |
| ★職務名稱 | 設備維修/廢水處理實習生 |
| ★職務類型 | □OP □RD ■維護 |
| ★部門(或產線) | 維護處 |
| ★地點(或廠區) | 金像電子中壢廠 |
| ★主要工作內容描述 | 1.PCB設備保養&維修2.公共&廢水設備保養&維修3.TPM執行&分析改善4.PLC程式判讀與編輯5.環保&工安相關預防工作檢查 |
| ★實習期間(可複選) | □暑期(2022.7~8月)□學期(2022.9~2023.1)■學期(2023.2~2023.6) |
| ★所需人數 | 3人 |
| ★時數/天數(最低需求) | 每周至少： 40時(或)每周至少： 5 天 |
| ★加班需求 | □需要□不需要■未定 |
| 希望校/系 | 工程/數理化學群(電機/機械/環工系尤佳) |
| 英文能力 | □略懂 ■中等 □精通 |
| 其他條件要求(技能/語言/軟體/證照等) | □修過電路板學分班□通過電路板工程師初級□其他 |
| 其他需要檢附之資料 | ■履歷 ■成績證明□其他： |
| ★實習職缺屬性 | □僅為階段支援 ■期待後續留任□待評估 |
| ★職缺有效期限 | □提出申請後3個月內■提出申請後3-6個月□長期性職缺(不限時) |

1. **其他問題與建議：**(歡迎自行填寫)

|  |
| --- |
| **1.以上實習職務媒合後皆需至金像104公告之實習崗位，投遞履歷及相關資料報名**[**https://www.104.com.tw/company/e7y1qlc?jobsource=checkc**](https://www.104.com.tw/company/e7y1qlc?jobsource=checkc)**2. 工程師職缺希望校系補充 :** **(1)學校：國立台灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立政治大學、國立中央大學、國立中興大學、國立中正大學、國立中山大學、國立台灣師範大學、國立台北大學、國立台灣海洋大學、國立彰化師範大學、國立聯合大學、國立高雄大學、國立台灣科技大學、國立台北科技大學、國立高雄科技大學、國立雲林科技大學、國立臺北商業大學、國立台中科技大學、國立虎尾科技大學、國立勤益科技大學、私立中原大學、私立元智大學、私立東海大學、私立逢甲大學、私立長庚大學、私立輔仁大學、私立東吳大學、私立淡江大學、私立中國文化大學、私立台北醫學大學、私立中國醫藥大學。****(2)系所：材料、電子、電機、機械、化工、化學、數學、物理、統計等理工相關系所。** |

**TPCA窗口:**03-3815659 曾乙玲#506 lisa@tpca.org.tw ; 陽浩天#501 keith@tpca.org.tw

1. ★必填**實習計畫書：**(1)一個職務填寫一份表格 (2)本表格若有不足歡迎自行延伸使用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(1)****職****務名****稱****：****製程工程實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.巡視製程作業程序和品質2.協助品質缺點分析和彙整資料3.追蹤實驗板進度、品質和彙整資料 |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一個月 | 1.熟悉環境2.認識部門主管和職務3.PCB基礎流程簡介4.常用系統操作介紹5.製程進階介紹 | 瞭解工程負責職掌、PCB基礎流程、常用系統操作和製程作業流程 |
| 第二個月 | 1. 製程重要管控項目介紹
2. 製程作業程序和品質缺點
 | 瞭解製程重要管控項目和品質缺點認知 |
| 第三個月 | 1. 參與巡視製程作業程序
2. 參與追蹤實驗板進度
 | 瞭解製程作業實況 |
| 第四個月 | 1. 巡視製程作業程序
2. 追蹤實驗板進度和彙整品質結果
3. 參與製程品質缺點分布和作業資訊
 | 製程品質缺點分析 |
| 第五個月 | 1. 巡視製程作業程序
2. 追蹤實驗板進度和彙整品質結果
3. 參與製程品質缺點分布和作業資訊
4. 實習報告及成果簡報
 | 製程品質缺點分析 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.熟悉PCB基礎流程2.製程品質缺點分析報告3.實驗板品質結果報告 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(2)****職****務名****稱****：****材料工程&技術開發實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.製程專案改善2.製程異常處理3.協助新產品開發4.新產品生產流程設計5.主管交辦事項 |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一/二週(7/4~7/15) | 1.介紹環境與認識資安2.認識公司部門組織與處內工作職掌3.認識傳統印刷電路板流程 | 瞭解公司組織、工作職掌及基礎PCB流程 |
| 第三/四週(7/18~7/29) | 1.學習與工作職掌相關之製程2.認識與工作職掌相關之部門功能 | 每日提出學習日誌 |
| 第五/六週(8/1~8/12) | 1.學習工作職掌之品質/工單/電子文件系統2.利用公司網站學習PCB相關資訊3.與導師討論訂定專案題目 | 每日提出學習日誌 |
| 第七/八週(8/15~8/26) | 1.確認並開始執行改善專案2.學習專案計畫3.學習簡報製作 | 每日提出學習日誌提出專案簡報進度 |
| 第三月(8/29~9/30) | 1.學習專案分析/資料收集2.學習改善對策制定 | 每日提出學習日誌提出專案簡報進度 |
| 第四月(10/3~10/31) | 1.學習與確認執行對策是否正確2.學習獨立思考與眾人討論之能力 | 每日提出學習日誌提出專案簡報進度 |
| 第五月(11/1~11/30) | 1.確認執行對策是否有效2.學習尋找相關改善對策能力 | 每日提出學習日誌提出專案簡報進度 |
| 第六月(12/1~12/30) | 1.簡報資料歸納2.學習上台報告能力 | 提出專案簡報初稿 |
| 第七月(1/3~1/20) | 1.提出簡報並報告2.學習”當責”精神 | 提出完整專案簡報學習”當責”精神 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.認知傳統印刷電路板作業流程2.可獨立執行專案能力3.獨立完成工作簡報 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(3)****職****務名****稱****：****新產品工程實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.樣品製作時,製程異常時排除與製作進度掌控2.樣品異常時改善修正及設計優化調整3.樣品良率彙整與對策提出4.作業途程與作業參數測試及驗證 |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一個月 | 1.認識環境2.認識金像製程3.認識部門主管 | 瞭解金像組織及PCB基礎流程 |
| 第二個月 | 1.製程簡介學習(一)2.製程異常處置(一)3.工單系統/WIP系統操作 | 1.製程熟悉度2.異常處置回報2.系統操作 |
| 第三個月 | 1.製程簡介學習(二)2.製程異常處置(二)3.MECN及VALOA系統操作 | 1.製程熟悉度2.異常處置回報2.MECN發行 |
| 第四個月 | 1.板面檢驗流程學習2.板面異常WAIVE處置3.品質檢驗及WAIVE系統操作 | 1.製程熟悉度2.異常處置回報3.WAIVE單建立 |
| 第五個月 | 1.發料規則說明及操作2.結案報告撰寫3.學習成效與心得分享 | 1.發料系統維護2.報告發行3.心得發表 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.重點製程異常自行排除2.異常問題分析確認及對策提出與發文修正3.製作資料匯整及交接 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(4)****職****務名****稱****：****D****R****C****分析實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.軟體操作 Genesis 與 InCAM Pro2.Gerber Input3.執行DRC分析4.撰寫DRC分析報告5.預排版設計6.他廠DRC分析 |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一週(9/5~9/8) | 1.熟悉環境2.認識設計工程處3.認識部門主管 | 瞭解設計工程處組織及部門作業流程 |
| 第二週(9/12~9/16) | 1.Genesis 與 InCAM Pro 操作2.料號命名原則 | CAM 編輯軟體操作 |
| 第三週(9/19~9/23) | 1.GERBER Import 方式與操作練習2.GERBER 屬性判斷3.層別命名方式 | 廠內層別命名方式 |
| 第四週(9/26~9/30) | 1.DRC分析- DRC1/DRC2 的分析操作與異常處理 | 學會 DRC 1/ DRC 2 的分析與系統異常處理方式 |
| 第五週(10/3~10/7) | 1.DRC其餘分析操作與異常處理 | 學會DRC 其他分析 |
| 第六週(10/11~10/14) | 1.DRC報告內容說明與填寫-鑽孔/防焊 | 解說鑽孔/防焊的報告內容與如何找出客戶設計的問題點 |
| 第七週(10/17~10/21) | 1.DRC報告內容說明與填寫-內層 | 解說內層的報告內容與如何找出客戶設計的問題點 |
| 第八週(10/24~10/28) | 1.DRC報告內容說明與填寫-外層 | 解說外層的報告內容與如何找出客戶設計的問題點 |
| 第九週(10/31~11/4) | 1.DRC報告內容說明與填寫-文字與其他特殊事項 | 解說文字與特殊事項的報告內容與如何找出客戶設計的問題點 |
| 第十週 (1/7~11/11) | 1.InCAM Pro的DRC分析方式 | 少部分功能必須使用 InCAM Pro，學會 InCAM Pro 分析 |
| 第十一週 (11/14~11/18) | 1.客戶Net Compare 與分析 | 如何比對客戶提供的 NET 與 GERBER 設計是否一致，若有不符，如何找出GERBER 設計的問題處 |
| 第十二週 (11/21~11/25) | 1.預排版教學2.他廠 DRC 分析的差異與判斷方式 | 藉由預排版功能，讓 OP 設計結構能更符合客戶要求代工其他廠 DRC 注意事項 |
| 第十三週 (11/28~12/2) | 1.實際操作練習 | 操作練習 |
| 第十四週(12/5~12/9) | 1.成效驗收，結訓心得報告 | 完成訓練驗收 |
| 第十五週起(12/12~12/30) | 上線作業 | 執行DRC分析任務 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.具備InCAM Pro及Genesis 2000之DRC軟體操作能力2.完成一般料號及HDI/ sequential料號之Gerber Input3.完成一般料號及HDI/ sequential料號之DRC分析4.完成一般料號及HDI/ sequential料號之DRC分析報告 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(5)****職****務名****稱****：****C****A****M實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.電路板線路影像編輯2.補償及排版3.製程能力分析及Netlist比對4.治工具輸出5.製程改善 |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一週(7/4~7/8) | PCB製程簡介及底片製作原理 | 內層作業流程考試 |
| 第二週(7/11~7/15) | PCB製程簡介及底片製作原理 | 鑽孔,雷射,背鑽考試 |
| 第三週(7/18~7/22) | PCB製程簡介及底片製作原理 | 外層作業流程考試 |
| 第四週(7/25~7/29) | PCB製程簡介及底片製作原理 | 防焊文字作業流程考試 |
| 第五週(8/1~8/5) | Genesis基本操作 | 阻抗coupon layout |
| 第六週(8/8~8/12) | 鑽孔, Laser, 背鑽製作 | 程式帶製作及輸出 |
| 第七週(8/15~8/19) | 底片補償 | 內層線路及GND補償 |
| 第八週(8/22~8/26) | Panel 排版 | 內層底片排版輸出 |
| 第九週(8/29~9/2) | 學習心得及Q&A | 學習心得報告 |
| 第一月(9/2~9/30) | 內層底片編輯實做 | 產出內層工作稿 |
| 第二月 (10/1~10/31) | 內層底片編輯實做 | 產出內層工作稿 |
| 第三月 (11/1~11/30) | 鑽孔程式編輯輸出 | 產出鑽孔程式 |
| 第四月 (12/1~12/31) | 背鑽, Laser, 塞孔片製作 | 產出背鑽, Laser, 塞孔片 |
| 第五月(2/1~2/28) | 外層底片編輯實做 | 產出外層工作稿 |
| 第六月(3/1~3/31) | 外層底片編輯實做 | 產出外層工作稿 |
| 第七月(4/1~4/30) | 防焊底片編輯實做 | 產出防焊工作稿 |
|  第八月 (5/1~5/31) | 防焊底片編輯實做 | 產出防焊工作稿 |
|  第九月 (6/1~6/30) | 文字底片編輯實做 | 產出文字工作稿 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.Genesis 系統操作2.PCB製程原理 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(6)****職****務名****稱****：****客服實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.客訴處理2.廠內外溝通協調能力培養3. RMA 判定與開立4.週、月報處理(廠內、客戶端)5.參與客戶端會議預排版設計 |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 7月(7/4~7/29) | ●GCE公司組織/產品別介紹●PCB產品基礎認識●客服組織工作職責認識 | 了解GCE組職及PCB基礎流程，以及客服工作範疇及職責所在。 |
| ●PCB全製程簡略說明●設工介紹(front-end process)●製一簡介(內層->內檢)●Plant tour | 熟悉PCB基本流程，並了解前端製程基本概況及製造現場作業狀況。 |
| ●製二簡介(棕化壓合)●製二簡介(鑽孔)●Plant tour | 熟悉製造二部(壓合、鑽孔)的基本流程及作業方式。 |
| ●製二簡介(棕化壓合)●製二簡介(鑽孔)●Plant tour | 熟悉製造二部(壓合、鑽孔)的基本流程及作業方式。 |
| 8月 (8/1~8/29) | ●製三簡介(電鍍、外層乾膜、二銅)●Plant tour | 熟悉製造三部(PTH、外層覆膜、二銅)的基本流程及現場作業概況。 |
| ●製三簡介(電鍍、外層乾膜、二銅)●Plant tour | 熟悉製造三部(PTH、外層覆膜、二銅)的基本流程及現場作業概況。 |
| ●製三簡介(外層蝕刻、半檢)●Plant tour | 熟悉製造三部(外層蝕刻、外層半檢)的基本流程及現場作業概況。 |
| ●製四簡介(防焊、文字、表面處理)●Plant tour | 熟悉製造四部(防焊文字、表面處理)的基本流程及現場作業概況。 |
| 9月(9/2~9/30) | ●製四簡介(成型、電測、修三、FQC)●Plant tour | 熟悉製造四部(成型、電、修三、OQC)的基本流程及現場作業概況。 |
| ●全廠Plant tour製程介紹練習(中文) | 具備全製程介紹的基本能力，可帶領客戶巡廠並介紹基本製程。 |
| ●全廠Plant tour製程介紹練習(英文) | 具備全製程介紹的基本能力，可帶領國外客戶巡廠並介紹基本製程。 |
| ●客服作業系統學習(Oracle/Mygce)●資訊系統學習(工單、WIP…)○實習訪談(確認實習生學習狀況) | 熟悉GCE資訊系統及客服作業使用系統，並訪談瞭解實習狀況，是情況調整後續實習排程 |
| 10月 (10/3~10/28) | ●異常現象學習(外觀、內/外層)●IPC規範學習●外觀維修學習(FQC) | 瞭解基礎PCB產品異常狀況/成因及IPC允收規範，並熟悉外觀不良維修方式。 |
| 11月、12月 (11/4~11/28)(12/2~12/30) | ●外觀維修實戰(至客戶端實際覆判維修)○實習訪談(確認實習生學習狀況) | 瞭解客戶端作業概況並透過覆判維修實戰經驗瞭解客戶需求，將客戶需求傳遞廠內，培養內外部溝通協調能力。訪談瞭解實習生作業狀況，確認後續實習排程是否需進行調整。 |
| 1月、2月、3月(1/2~1/30)(2/3~2/27)(3/3~3/31) | ●協助客訴處理(召開客訴會議/會議記錄/資料收集)以及客戶周月報更新。○實習訪談(確認實習生學習狀況) | 瞭解客訴會議召開模式，以及客訴處理SOP及相關資料收集方式，並熟悉國內外客戶別及例行工作(周月報)，培養內部溝通能力。 |
| 4月、5月、6月(4/3~4/28)(5/1~5/29)(6/2~6/30) | ●客訴處理實戰(例行客訴處理/主導客訴會議)○實習訪談(確認實習生學習狀況) -實習結訓- | 可獨立作業處理客訴專案、應對客戶需求問題、參與客戶周月會，具備完整溝通應答能力。 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.培養製作週/月報表，與滿足廠內/客戶端資料彙整需求的整合能力2.與客戶信件往來，與客訴報告撰寫，養成商業書寫專業能力3.可獨立完成客訴會議主持，與廠內/客戶端溝通協商的表達能力4.完整具備客服工程師所需溝通協調與推動問題改善能力 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(7)****職****務名****稱****：****可靠度實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.執行產品可靠度測試及問題分析2.可靠度分析報告撰寫與彙整3.實驗設備操作與維護4.可靠度分析報告撰寫與彙整 |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一週(9/1~9/8) | 1.熟悉環境2.認識PCB製程3.認識部門主管 | 了解金像製作流程及單位作業流程 |
| 第一月(9/12~9/30) | 1.可靠度SOP G-QP-02產品可靠度試驗作業程序研讀2.IPC-TM-650研讀 | 各項實驗程序差異結果彙整表 |
| 第二月(10/3~10/31) | 實際依IPC-TM-650作業程序操作-part 1 | 各項實驗實際操作差異結果彙整表 |
| 第三月(11/1~11/30) | 實際依IPC-TM-650作業程序操作-part 2 | 各項實驗實際操作差異結果彙整表 |
| 第四月(12/1~12/30) | 失效分析資料閱讀及撰寫邏輯訓練 | 建立失效分析模版 |
| 第五月(1/2~1/31) | 化金上鍚不良失效分析模版撰寫 | 化金上鍚不良失效分析模版建立 |
| 第六月(2/1~2/28) | 實際操作分析化金上鍚不良案件 | 產出1份化金上鍚不良報告 |
| 第七月(3/1~3/31) | ICD不良失效分析模版撰寫 | ICD不良失效分析模版建立 |
| 第八月(4/3~4/28) | 實際操作分析ICD上鍚不良案件 | 產出1份ICD不良報告 |
| 第九月(5/1~5/31) | 認證板報告模版撰寫 | 認證板報告模版建立 |
|  第十月 (6/1~6/30) | 學習成效心得報告 | 分享報告模版及IPC-TM650報告 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.完成2份失效分析模版建立2.完成SOP及TM-650作業程序實際操作比對3.完成認證板報告模版建立 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(8)****職****務名****稱****：****PQE實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.異常處理2.統計分析3.專案進行 |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一週(9/1~9/8) | 1.熟悉環境2.認識PCB製程3.認識部門主管 | 了解金像製作流程及單位作業流程 |
| 第一月(9/12~9/30) | 製程介紹 | 工單流程、料號、批號等如何辨識 |
| 第二月(10/3~10/31) | 檢驗規範介紹 | 檢驗項目、標準、手法、抽樣計劃 |
| 第三月(11/1~11/30) | 資訊系統應用 | 品質管制系統、過帳管理系統、MYGCE簽核流程 |
| 第四月(12/1~12/30) | 四功能訓練 | DRT報告 |
| 第五月(1/2~1/31) | 基本功考核 | 基本功人員實作、筆試 |
| 第六月(2/1~2/28) | 統計手法訓練、MECN檢定分析、SPC | 層別分析報告 |
| 第七月(3/1~3/31) | MSA教育訓練 | 設備精度、準度、穩定性分析、Kappa |
| 第八月(4/3~4/28) | 異常處理流程 | 產品處置、異常原因分析 |
| 第九月(5/1~5/31) | 專案獨立訓練 | 結案報告 |
| 第十月(6/1~6/30) | 學習成效心得報告 | 分享學習心得 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.能獨立進行基本功認證2.熟悉MSA, SPC等手法, 可獨立處理異常3.參與四功能運作, 能提出改善建議 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(9)****職****務名****稱****：****大數據分析實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.資料收集2.資料整理3.資料分析與建模4.協助模型上線 |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一週 | 1.了解金像環境及廠內各部門功能說明 | 了解各製程及各部門所在的位置 |
| 第二週 | 1.學習內層及壓合製程及其重要品質特性2.連續型數據統計分析方法I | 了解內層、壓合input與output資料的關係 |
| 第三週 | 1.學習鑽孔及電鍍製程及其重要品質特性2.連續型數據統計分析方法 II | 了解鑽孔、電鍍input與output資料的關係 |
| 第四週 | 1.學習外層及蝕刻製程及其重要品質特性2.離散型數據統計分析方法I | 了解外層、蝕刻input與output資料的關係 |
| 第五週 | 1.學習防焊及文字製程及其重要品質特性2.離散型數據分析方法II | 了解防焊、文字input與output資料的關係 |
| 第六週 | 1.學習成型及修三製程及其重要品質特性2.量測系統分析與抽樣計劃 | 了解成型、修三input與output資料的關係 |
| 第七週 | 1.工單系統、WIP系統介紹2.資料庫系統架構介紹 | 從資料庫取資料 |
| 第八週 | 1.自動化數據分析系統及報表分析系統2.Python程式語言介紹 | 簡易分析與程式編輯 |
| 第九週 | 1.資料整理2.資料分析 | 協助資料整理與分析工作 |
| 第十週起 | 1.上線作業 | 完成數據分析交辦工作 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.了解各製程的重要品質特性2.協助收集與整理資料3.協助完成資料分析、建立模型與發佈模型 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(10)****職****務名****稱****：****程式開發實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.使用Fine Report報表工具參與資訊處專案的報表開發。 |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一週(7/4-7/8) | 1.孰悉環境 2.認識部門主管3.認識金像製程 | 了解金像組織及PCB基礎流程 |
| 第二週(7/11-7/15) | 1.了解Fine Report功能2.學習SQL查詢語句 | 依教材-掌握Fine Report工具基礎操作能力 |
| 第三週(7/18-7/22) | 1.Fine Report入門課程學習 | 依教材-了解Fine Report功能及優勢，可以實現哪些效果，並通過視覺化展示和交互式的操作，直觀了解這些效果 |
| 第四週(7/25-7/29) | 1.報表設計實戰練習 | 依教材-使用Fine Report工具設計報表 |
| 第五週(8/1-8/5) | 1.專案人員說明進行中專案內容以及其需求。2.製作報表分析文件並設計報表。 | 製作報表分析文件 |
| 第六週(8/8-8/12) | 1.報表實作 | 報表製作進度報告 |
| 第七週(8/15-8/19) | 1.報表實作 | 報表製作完成 |
| 第八週(8/22-8/26) | 1.對使用單位發表報表操作使用 | 報表操作文件 |
| 第九週(8/29-9/2) | 1.收斂學習成效、結訓心得報告 | 實習心得報告 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.了解如何從需求中設計一個報表。2.學習Fine Report報表工具的應用。3.於進行的專案中，參與報表開發。使用Fine Report報表工具，從需求分析中獨立開發一個報表並對使用者發表說明。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(11)****職****務名****稱****：****生產管理實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.生產進度安排2.QTA 料號之啟動及追蹤3.客戶訂單OTD管控4.半成品WIP及成品庫存量管控5.Surplus 管控 |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 第一個月  | 1.環境認識2.工作伙伴認識3.PCB主要製程認識 | 1.熟悉公司環境及相關人員2.熟悉PCB主要之製程 |
| 第二個月 | 發料及開立製令作業流程之認識及實際操作 | 操作發料程式及開立製令、發料單 |
| 第三個月 | 裁板、內層排程之認識及演練 | 能獨立完成裁板及內層之生產排程 |
| 第四個月 | 實際負責裁板及內層站之生產排程及追蹤進度 | 能掌握現場進度，若有異常能主動提出及管控 |
| 第五個月 | 實際負責裁板及內層站之生產排程及追蹤進度 | OTD 實際成績之掌控度 |
| 第六個月起 | 上線作業 | 完成生產排程任務 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.能夠獨立完成生管排程之安排。2.能夠與現場單位溝通及協調。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(12)****職****務名****稱****：****測試工程****&維修工程師** | **此職務之緣由說明** | 1.機台保養/維修(保持穩定稼動)。2.量產TROUBLE SHOOTING 。3.重要料號跟催。4.AOI DRT改善。5.SOP/PMP/CHECKLIST制訂。6.設備評估(架線)。7.現場人員教育訓練。8.開發導入新設備。 |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 2月 | 1.熟悉環境2.認識金像製程3.認識部門主管/基本設備 | 瞭解PCB基礎流程瞭解設備安全裝置功能和基本操作介面 |
| 3月 | 1.熟悉設備操作2.熟悉SOP | 瞭解設備操作及PCB基礎流程 |
| 4月 | 1.熟悉設備操作2.學習設備簡易設備故障排除3.熟悉SOP | 瞭解設備操作及簡易設備故障排除 |
| 5月 | 1.熟悉設備操作2.SOP/PMP/CL表單制定3.DRT改善 | 瞭解設備操作及文件修改事項 |
| 6月 | 1.學習檢測設備操作及保養項目執行2.學習SOP/PMP/CL/TPM3.收斂學習成效、結訓心得報告 | 檢驗設備操作/SOP相關增修實習心得報告 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.有獨立申請修改SOP系統操作能力2.基本檢測設備、AOI設備維修能力 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **(13)****職****務名****稱****：****設備維修****&廢水處理實習生** | **此職務之緣由說明** | 1.PCB設備保養&維修2.公共&廢水設備保養&維修3.TPM執行&分析改善4.PLC程式判讀與編輯5.環保&工安相關預防工作檢查 |
| **具體實習內容排程** | **期間** | **實習之工作內容/方式** | **預期完成項目/能力** |
| 2月 | 1.熟悉環境&了解維護工作安全守則2.熟悉備品料號建立規則及領料方式3.熟悉廠內管路配置與標示方式 | 了解維護處組織,部門作業流程&工作安全意識 |
| 3月 | 1.認識廢水&空汙設備處理原理2.了解十大工安專案項目與執行方式3.學習塑料與金屬焊接 | 了解空汙,廢水處理方式&機械簡易維修 |
| 4月 | 1.認識氣壓與油壓控制原理2.認識各種電控元件構造與原理3.汙泥機操作與簡易維修 | 了解設備控制元件構造原理 |
| 5月 | 1.傳統電路符號判讀與電路設計2.傳統電路配線3.廢水水質分析&異常處理 | 學會傳統簡易控制迴路設計 |
| 6月 | 1.認識PLC&人機構造原理2.認識PLC軟體,階梯圖與符號3.PLC基本指令編輯 | 學會PLC簡易程式設計 |
| **期待實習後可達成之目標** | 1.具備基本自動控制專業知識2.具備廢水處理能力3.具備機械與管路焊接能力4.了解PLC構造原理&基本指令判讀 |

**TPCA窗口:**03-3815659 曾乙玲#506 lisa@tpca.org.tw ; 陽浩天#501 keith@tpca.org.tw

**《電路板產業實習媒合平台》**

**企業申請表-填寫說明**

1. **公司基本資料**

請填寫公司基本聯繫資料、與本專案之聯絡窗口人員(建議為人資部門先進)。

1. **公司招募訊息**
2. 公司介紹(必填)：介紹公司緣由、特色、主力產品(或服務)等資訊，以吸引學生在最短時間，可了解與掌握貴公司之訊息，以利來提升媒合成功之機率。
3. 薪資(必填)：可為時薪制或月薪制，並請符合政府法規所要求之最低薪資。
4. 保險(必填)：屆時需為學生投保勞保，若有其他保險福利也歡迎填寫告知。
5. 膳宿：如針對實習期間之餐飲、住宿、交通等項目，有提供實際支援或金額補助，也請填寫告知。
6. 其他福利：非上述1~4點，歡迎於此欄位新增填寫，以利提升媒合成功之機率。
7. 給實習生的招募說明：針對本實習職缺，對有意投此職務之學生所要做的招募說明，歡迎盡可能活潑生動，以利提升媒合成功之機率。
8. 未來若成為正職員工之其他福利：可於此提供與釋放公司更多的福利或前景資訊，來鼓勵實習學生，於實習結束後，積極於該企業繼續工作留用，成為正式員工。
9. **實習條件申請表**
10. 職務名稱(必填)：供校方轉達此資訊給學生，透過職稱對實習工作有概略認識。
11. 職務類型(必填)：供學生依照意願選擇職務類型，媒合過程中較不容易產生落差。
12. 部門(或產線) (必填)：讓學生針對工作部門(或產線)有概略認識，填寫清楚可避免實習開始後產生過大落差。
13. 地點(或廠區) (必填)：讓學生了解實習地點(或廠區)後，學生可針對工作地點進行篩選。
14. 主要工作(必填)：供校方轉達此資訊給學生，學生可以先行規劃是否符合未來志趣，避免雙方時間浪費。
15. 內容描述(必填)：供校方轉達此資訊給學生，請盡可能詳盡，以利校方在轉達時能更加完整說明，幫助學生釐清興趣。
16. 實習期間(可複選) (必填)：供校方轉達此資訊給學生，確認實習期間完全可以配合公司。
17. 所需人數(必填) ：供校方轉達此資訊給學生。
18. 時數與輪班(每周) (必填)：供校方轉達此資訊給學生，確認實習時數與輪班狀況完全可以配合公司。
19. 時數/天數(最低需求) (必填)：供校方轉達此資訊給學生，確認實習時數/天數完全可以配合公司。
20. 加班需求(必填)：供校方轉達此資訊給學生，學生可評估是否能接受實習期間的加班。
21. 希望校/系：供協會協助於期待的校系中進行媒合，或協助找尋相對合適的校系。
22. 英文能力：如有需要語言能力也請加註，將依照申請表上詳列需求項目進行合適人才挑選。
23. 其他條件要求(技能/語言/軟體/證照等)：供校方轉達此資訊給學生。
24. 其他需要檢附之資料：供校方轉達此資訊給學生。
25. 實習職缺屬性(必填)：供協會協助與校方溝通，並安排合適的實習對象。
26. 職缺有效期限(必填)：供協會協助於職缺有效性內進行媒合，同時也避免補進人力時，職缺已過時，故請協助填寫職缺有效期限。
27. **其他問題與建議**

針對TPCA本專案或其他產學合作之任何環節，或對未來可能媒合之學校、教授、學生，有任何疑問或建議，歡迎可於此欄位填寫。

1. **實習計畫書**(必填)
2. 職務名稱：請對應第三點之職務名稱
3. 此職務之緣由說明：說明企業為何設有此項職務，或是此項職務為何設定為本專案之實習職務。
4. 具體實習內容排程：請依據實習整體期間，各階段中的具體工作內容、方式，以及在各階段中，期待實習學生可獲得的能力與完成之項目。
5. 期待實習後可達成之目標：說明本職務在完成整個實習排程後，應該達成的工作能力或目標為何。

註：實際具體實習內容排程仍依照廠商工作安排做彈性調整

**TPCA窗口:**03-3815659 曾乙玲#506 lisa@tpca.org.tw ; 陽浩天#501 keith@tpca.org.tw